

シールドソフトパッキング極薄タイプ

Ultrathin Shield Soft Packing

SSP-TH series



用途 Applications

- ▶ 携帯電話のグラウンディング & シールドリング。
- ▶ PDP/LCD の保護及びシールドリング。
- ▶ I/O パネル部のシールドリング。
- ▶ D-sub コネクタ部のシールドリング。

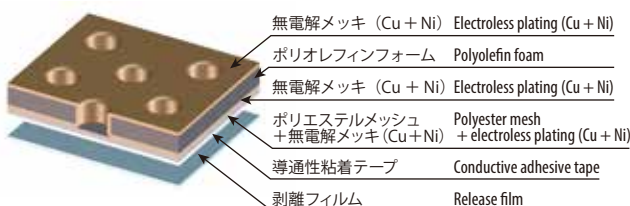
Cell phone grounding and shielding.
PDP/LCD protection and shielding.
Shielding of I/O panels.
Shielding of D-sub connectors.

品番表 Product list

[単位 Unit:mm]		
品番 Product code	厚み Thickness	定尺 Fixed sizes
SSP-003TH	0.3±0.06	300×500
SSP-005TH	0.5±0.10	300×500
SSP-007TH	0.7±0.14	300×500
SSP-010TH	1.0±0.20	300×500

※ご希望の形状による切断、打ち抜き、ハーフカット加工品での納入となります。
* Gaskets are cut off, die-cut, or kiss-cut into the desired shape before shipment.

構造 Structure



参考データ Reference data

No.	項目 Item	値 Value
1	厚み (mm) Thickness (mm)	0.3, 0.5, 0.7, 1.0 0.3, 0.5, 0.7, and 1.0
2	表面抵抗値 (Ω/□) Surface resistance (Ω/□)	0.25以下 0.25 or less
3	粘着力 (N/25mm) Adhesive strength (N/25 mm)	5以上 5 or more

(注) この数値は実測値で保証値ではありません。
* The values are not guaranteed.

特長 Features

- ▶ 新素材のポリオレフィンフォームにより厚みが薄くても十分にクッション性があります。
- ▶ 任意の形状に切断、打抜き、ハーフカットが容易にできカット時にバリ、ホツレの発生がありません。
- ▶ 貫通穴部にメッキが施されているため、表面の導通性及び圧縮方向での導通性が優れています。

The thin gasket provides high cushioning effects, thanks to polyolefin foam, a new material.

Gaskets are easily cut off, die-cut, or kiss-cut into various shapes without burrs or fraying.

The interior walls of through holes are plated. Offers high conductivity on the surface and along the axis of compression.

シールド効果 Shielding effect

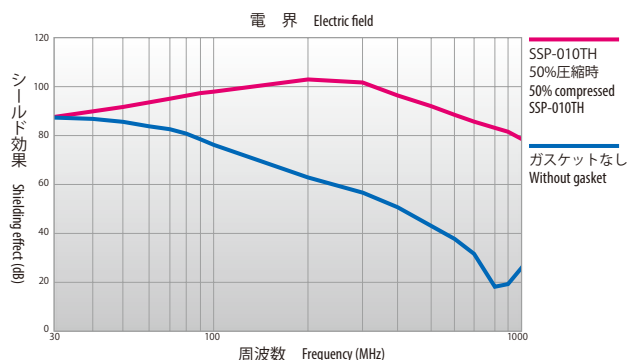
[測定方法]

50mm×70mm の開口部外周に試験サンプル (高さ 1mm/ 幅 10mm) を貼り付け、サンプル高さ 50%圧縮で開口部に蓋をする。

その際、試験サンプル (0.5mm の隙間) から漏れる電磁波を KEC 法で測定し、試験サンプルを取り付けない場合と効果を比較する。

[Measurement method]

Attach a test sample (1 mm high and 10 mm wide) around the outside edge of a 50 mm x 70 mm opening. Compress the sample until the height is reduced 50% and place the lid over the opening. Measure electromagnetic waves leaking from the test sample (through the 0.5 mm space) by the KEC method. Compare measurement results with and without the test sample.



本データは、KEC 法で測定した結果です。
The above data are measurements made by the KEC method.